

## 七、近三年內執行及申請中之研究計畫

### (一)、國科會

計畫名稱	計畫內擔任的工作	起訖年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
高遷移率高層數極薄通道的三維電晶體及支援技術(2/2)(111-2218-E-002-040-MBK)	共同主持人	2022/08/01 至 2023/10/31	國科會	執行中	11,600,000
先進奈米碳管技術對於半導體產業三維封裝的應用(109-2628-E-002-003-MY3)	主持人	2020/08/01 至 2023/07/31	國科會	執行中	3,621,000
智慧生物反應器之開發與其在培養體外 3D 組織之應用—總計畫暨子計畫五：智慧生物反應器微流體晶片暨 AI 微環境監控模組之開發(109-2221-E-002-069-MY3)	共同主持人	2020/08/01 至 2023/07/31	國科會	執行中	6,933,000
應用於亞洲矽谷奈米元件之自熱效應研究(106-2221-E-002-199-MY3)	主持人	2017/08/01 至 2020/10/31	國科會	已結案	3,617,000

### (二)、其它機構補助申請

計畫名稱	計畫內擔任的工作	起訖年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
晶圓推疊之機械特性與電特性模擬研究計畫	主持人	2021/04/01 至 2022/06/01	力晶積成電子製造股份有限公司	執行中	1,500,000